

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成27年7月9日 (2015.7.9)

【公開番号】特開2013-251372(P2013-251372A)
 【公開日】平成25年12月12日 (2013.12.12)
 【年通号数】公開・登録公報2013-067
 【出願番号】特願2012-124463(P2012-124463)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 1 L 23/14 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/12 5 0 1 B

H 0 1 L 23/14 S

【手続補正書】

【提出日】平成27年5月20日 (2015.5.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

上面に電子部品が搭載される配線基板であって、
 前記上面において、第 1 の方向に沿って配列され、前記電子部品の接続端子が接続される複数の第 1 パッドと、
結晶軸を有し、前記複数の第 1 パッドの配列方向に対して前記結晶軸が傾斜した基板本体と、
 を有することを特徴とする配線基板。

【請求項 2】

前記第 1 パッドが形成された上面側から見て、前記基板本体の結晶軸と前記第 1 パッドの配列方向とが互いに傾いて形成されてなることを特徴とする請求項 1 に記載の配線基板。

【請求項 3】

前記配線基板の外形は矩形状に形成され、
 前記複数の第 1 パッドの配列方向は前記外形と平行であること
 を特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の配線基板。

【請求項 4】

前記基板本体はシリコン単結晶基板であることを特徴とする請求項 1～3 のうちの何れか一項に記載の配線基板。

【請求項 5】

上面に電子部品が搭載される配線基板であって、
 前記上面に形成され、前記電子部品の接続端子が接続される複数の第 1 パッドと、
結晶軸を有し、前記配線基板の外形に対して前記結晶軸が傾斜した基板本体と、
 を有し、

前記複数の第 1 パッドは、前記配線基板の外形と平行に配列されたこと
 を特徴とする配線基板。

【請求項 6】

1 つの主面に複数の接続端子が形成された電子部品と、

上面に前記電子部品の接続端子が接続される複数の第１パッドが形成された配線基板と、
を有し、
前記複数の第１パッドは、前記上面において第１の方向に沿って配列され、
前記配線基板は、結晶軸を有し、前記第１の方向に対して前記結晶軸が傾斜した基板本体を含むこと、
を特徴とする半導体装置。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００５】

本発明の一観点によれば、上面に電子部品が搭載される配線基板であって、前記上面において、第１の方向に沿って配列され、前記電子部品の接続端子が接続される複数の第１パッドと、結晶軸を有し、前記複数の第１パッドの配列方向に対して前記結晶軸が傾斜した基板本体とを有する。